

WBBGA半导体封装基板HL832NXA钢性超薄多层电路板IC载板PCB

产品名称	WBBGA半导体封装基板HL832NXA钢性超薄多层电路板IC载板PCB
公司名称	深圳嘉圳电子科技有限公司
价格	29.00/个
规格参数	嘉圳:IC载板 BGA:WBBGA 深圳:宝安
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09
联系电话	18680337466 18680337466

产品详情

WBBGA，厚度0.4MM,6层，表面处理镍钯金，过孔工艺铜浆塞孔电镀填平，做小线宽线距2mil，半导体封装基板HL832NXA钢性超薄多层电路板IC载板PCB。